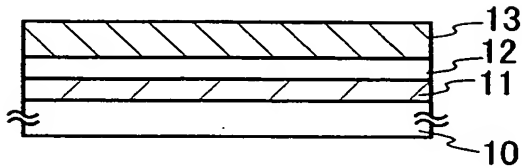


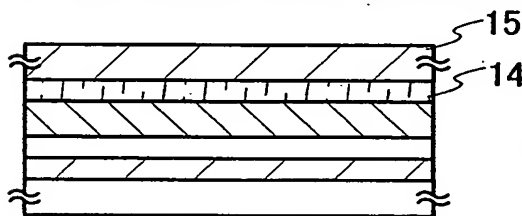
第1図

1/12

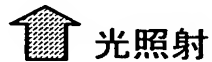
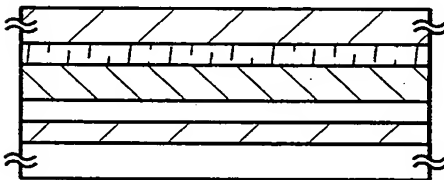
(A) 被剥離層の形成後



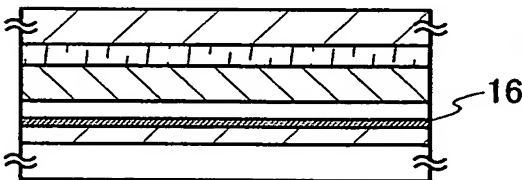
(B) 第2の基板15の接着後の状態



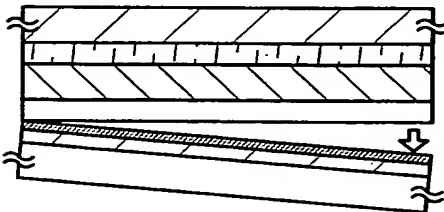
(C) 金属層11の酸化工程



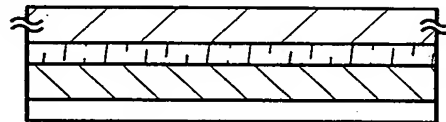
(D) 金属層11の酸化工程後の状態



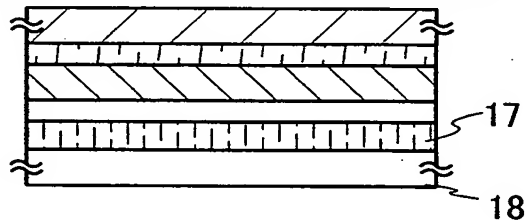
(E) 第1の基板10の剥離工程



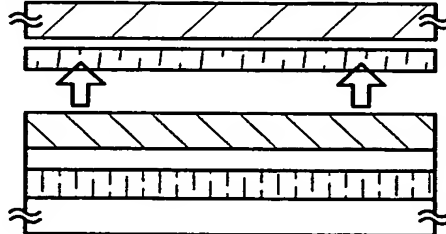
(F) 剥離後の状態



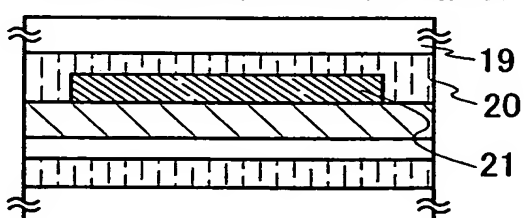
(G) 第3の基板18の接着後の状態



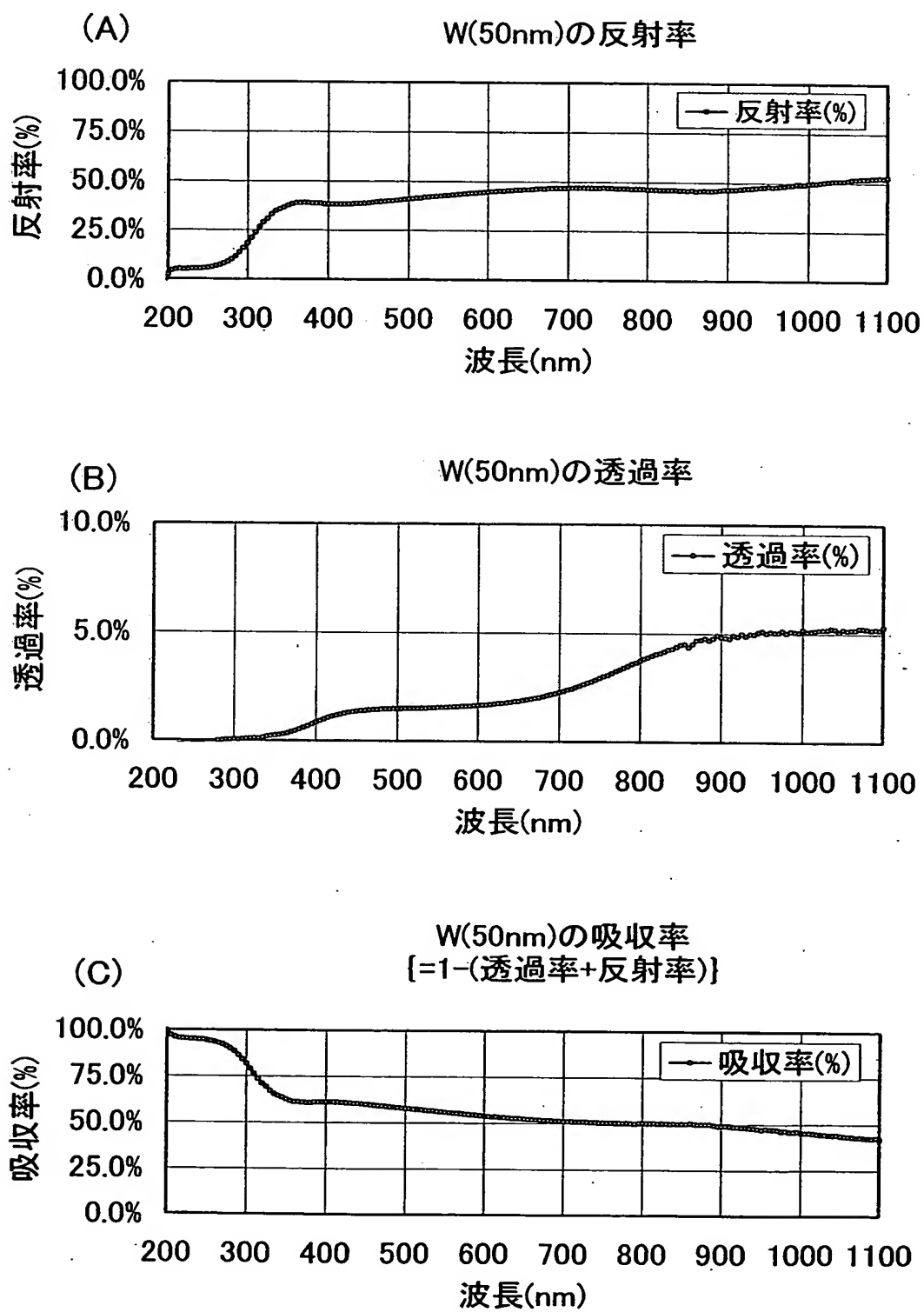
(H) 第2の基板の剥離工程

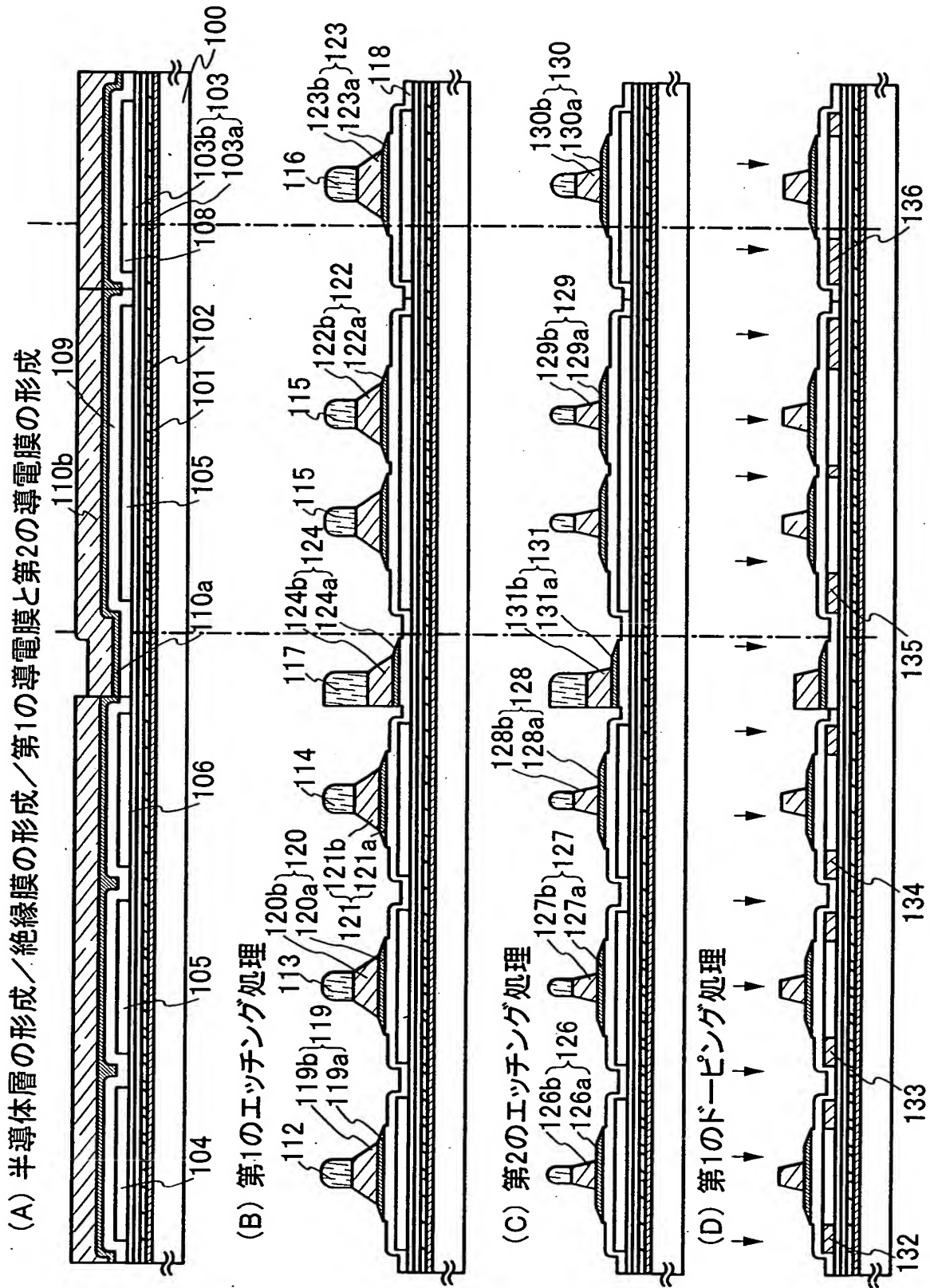


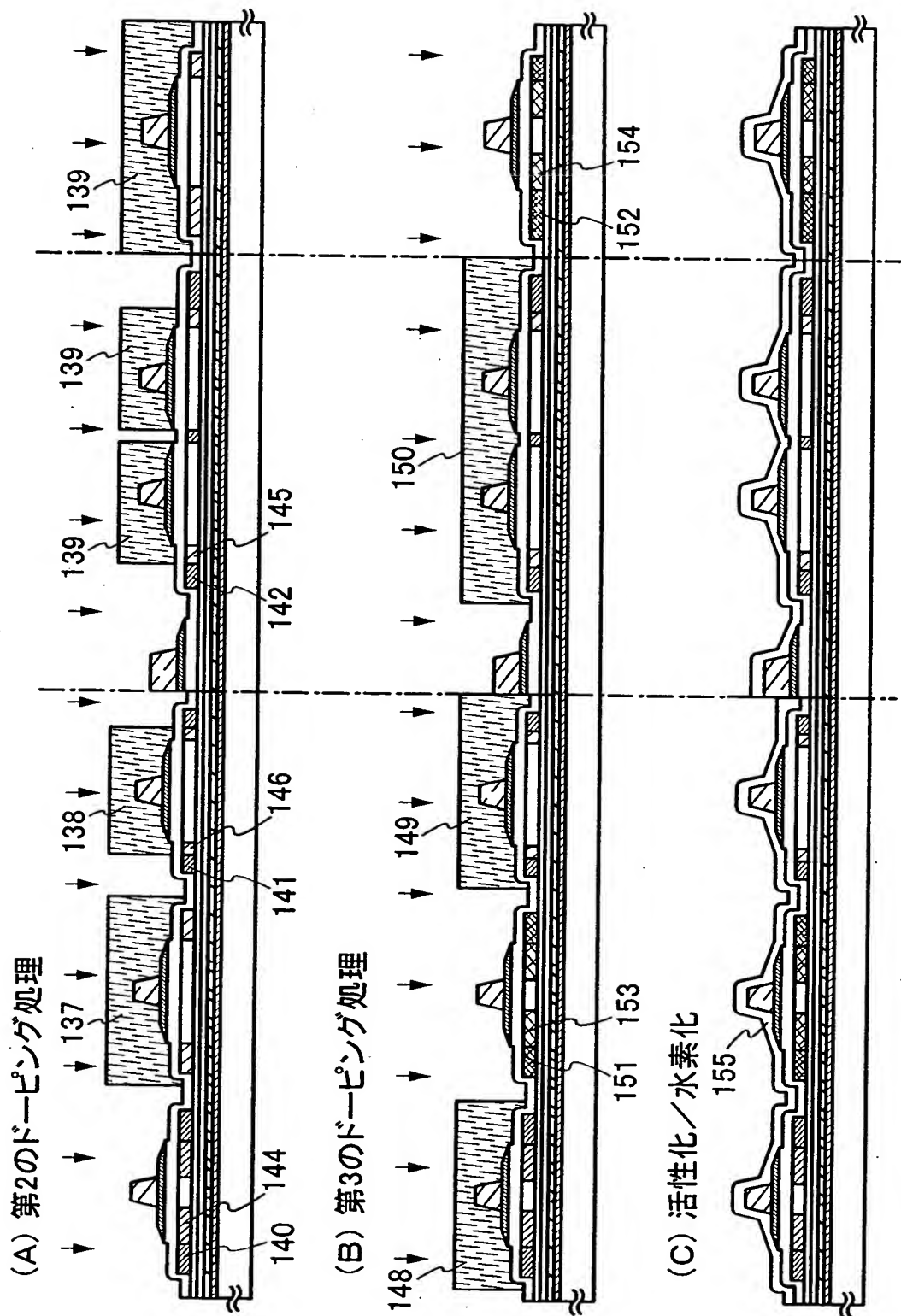
(I) EL層の形成、第4の基板の接着工程



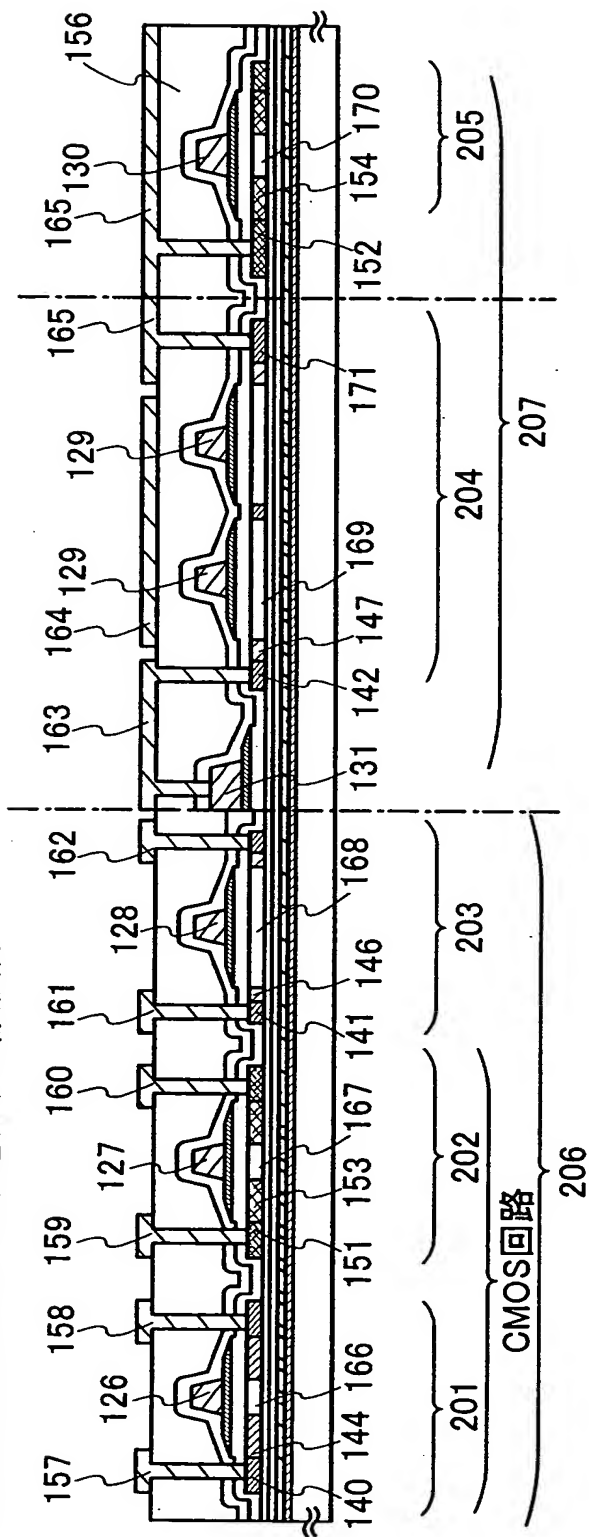
第2図







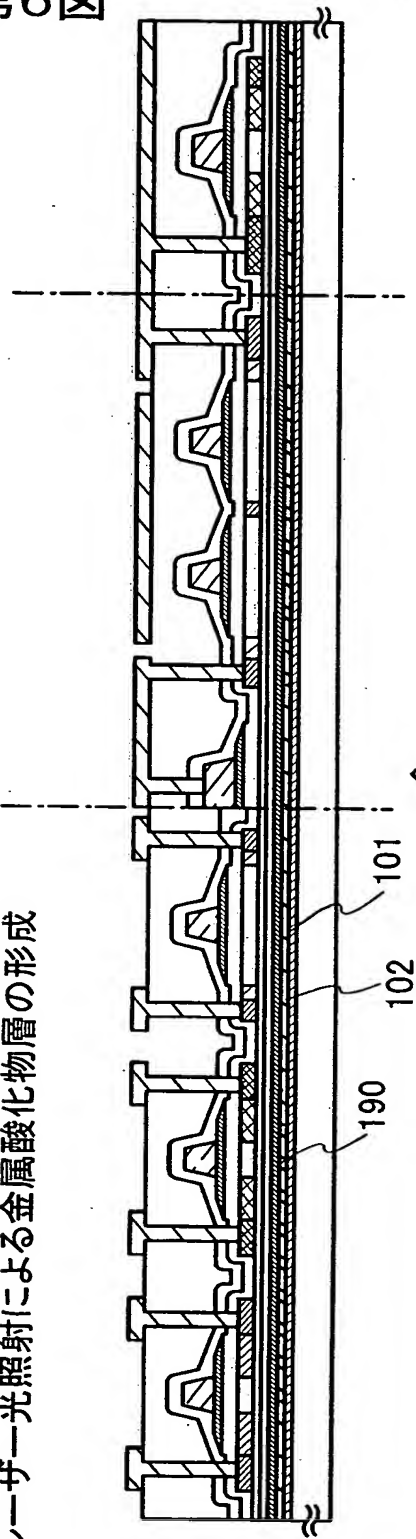
層間絶縁膜形成／画素電極、配線形成



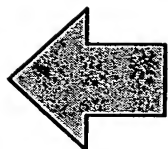
第6図

6/12

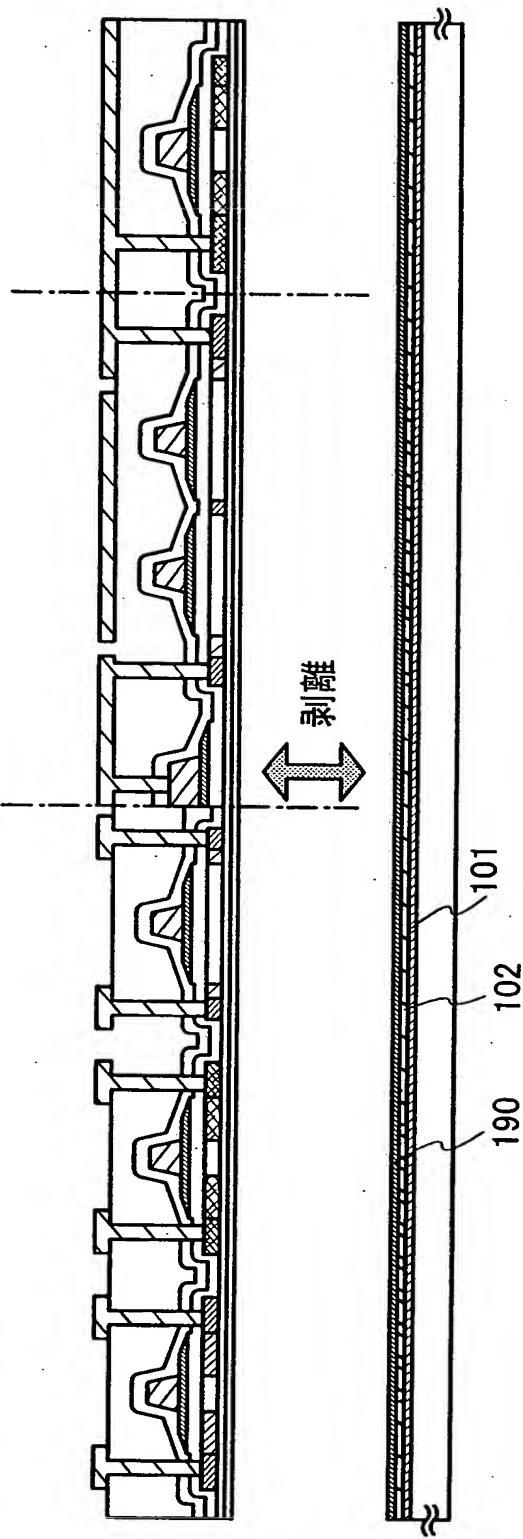
(A)レーザー照射による金属酸化物層の形成

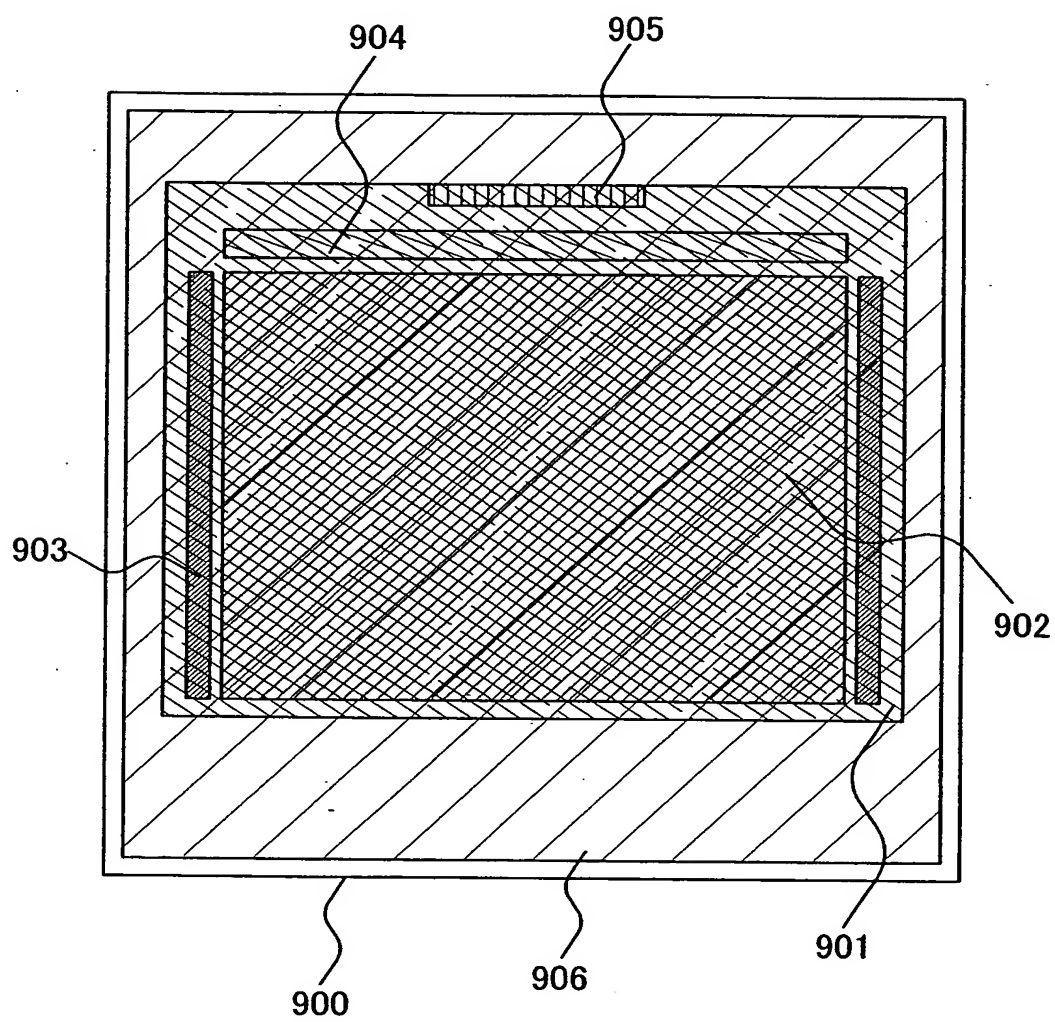


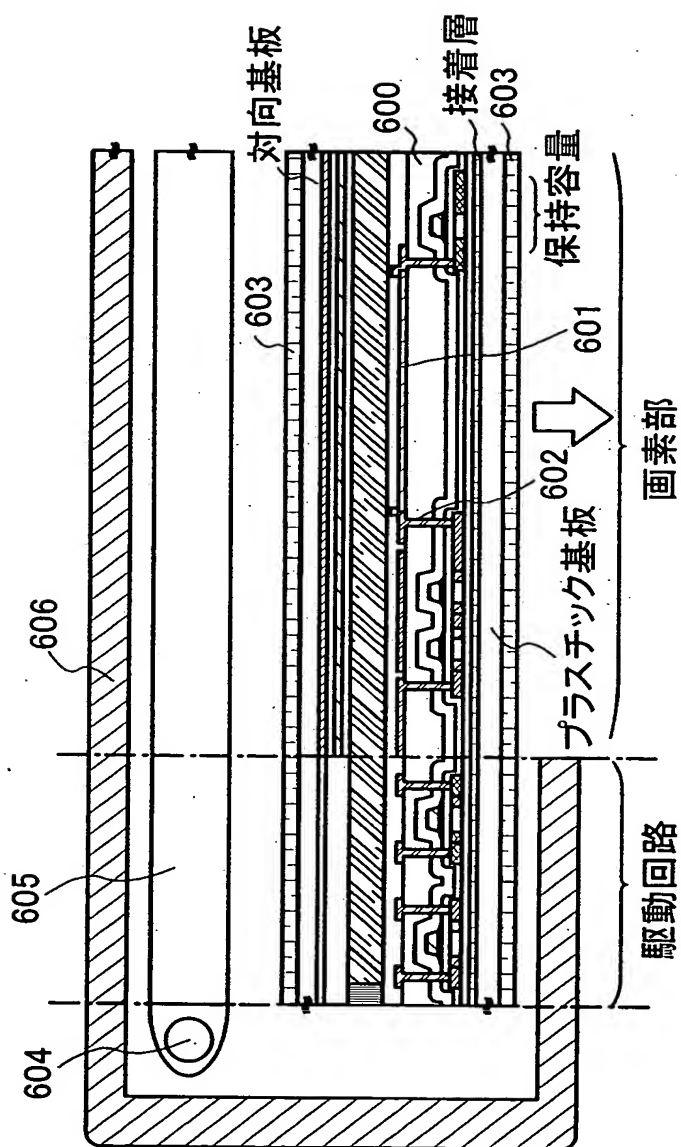
レーザー照射



(B)被剥離層の剥離

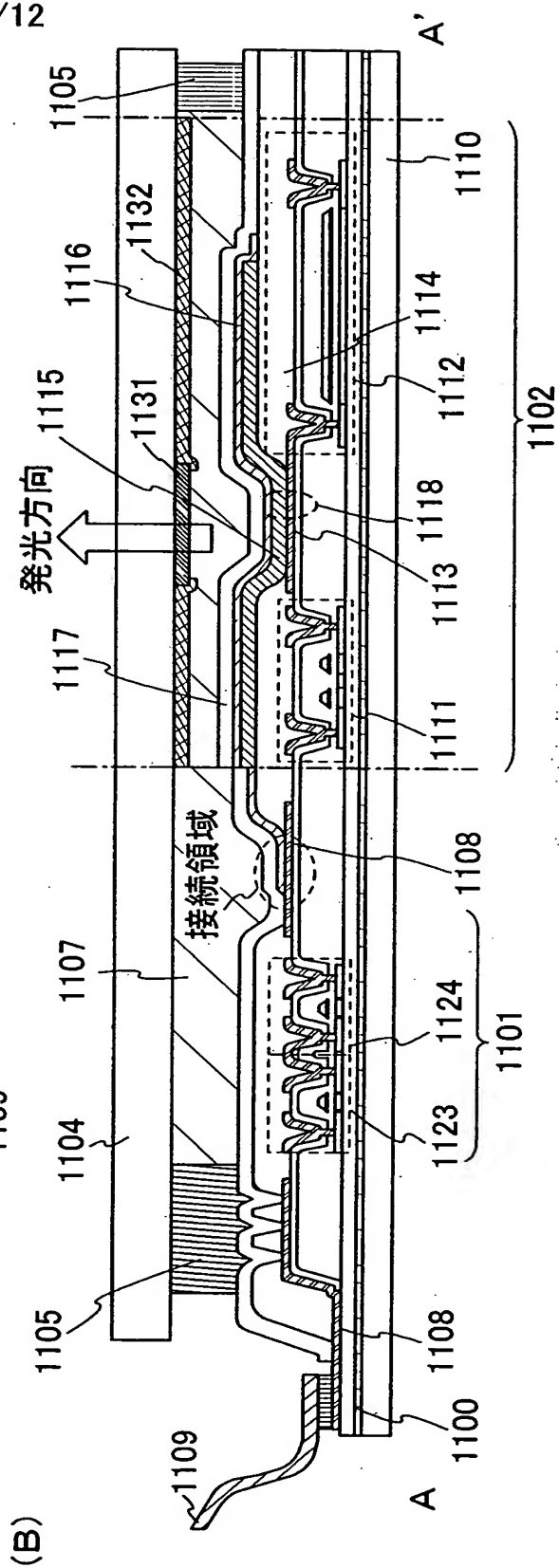
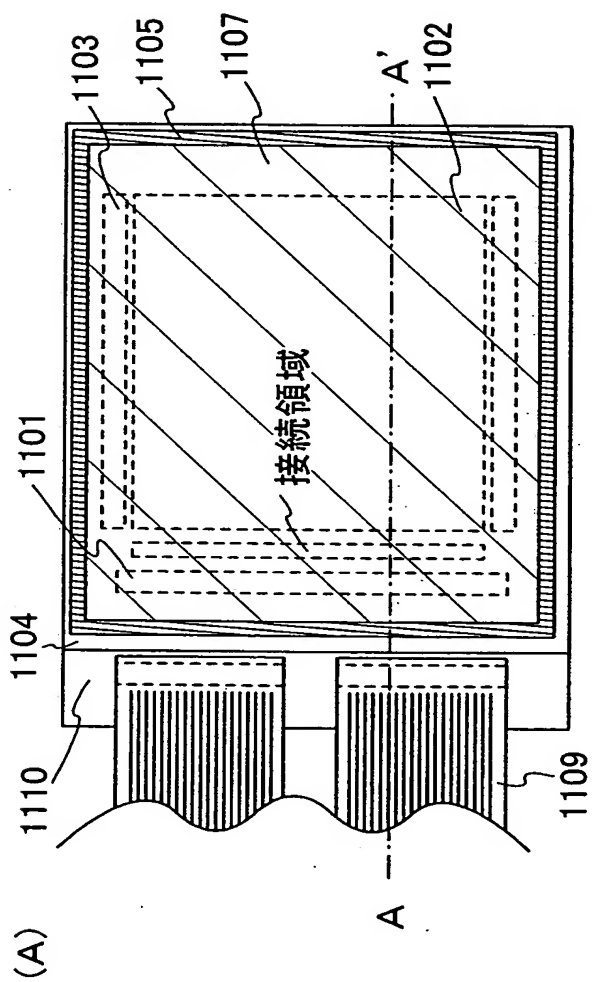






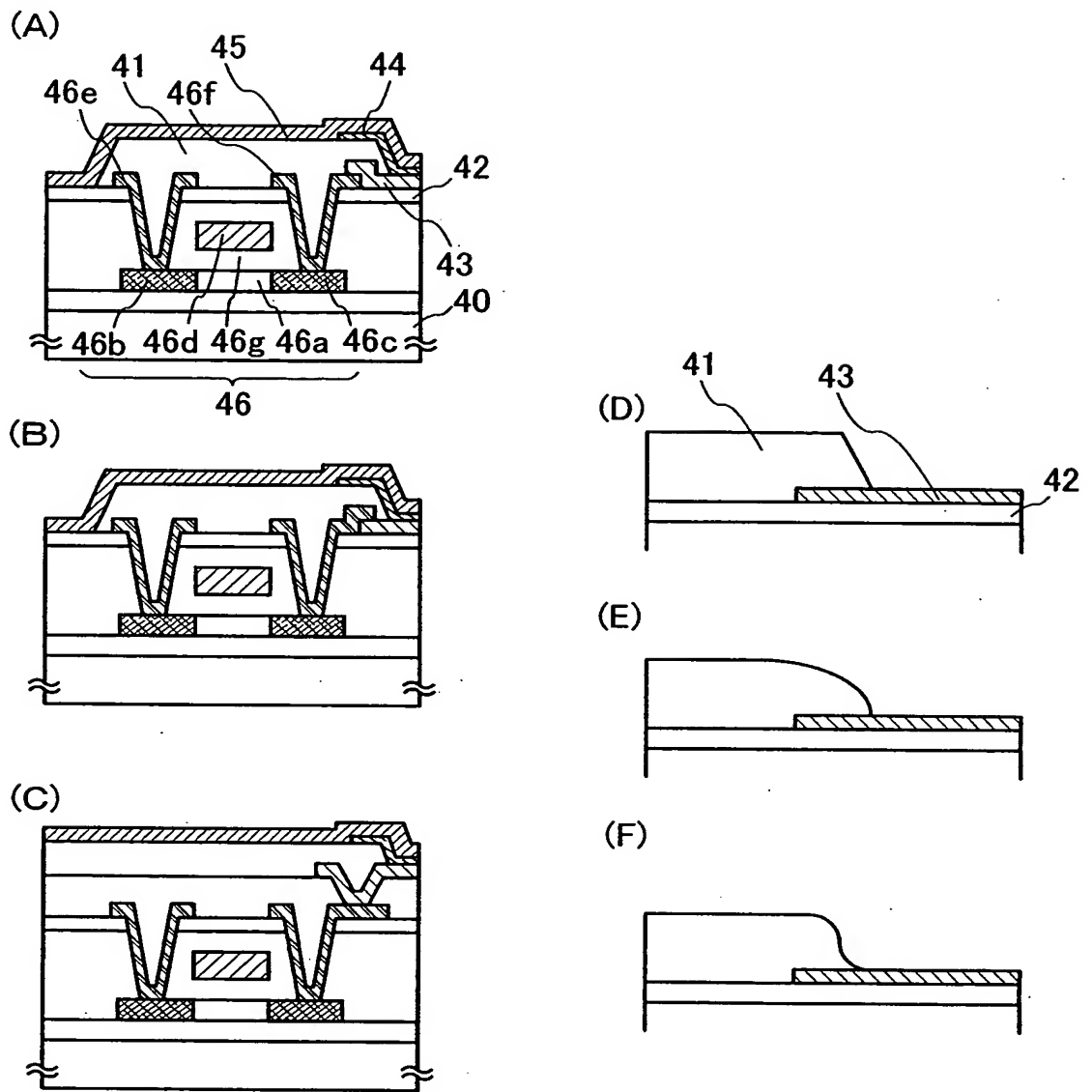
第9図

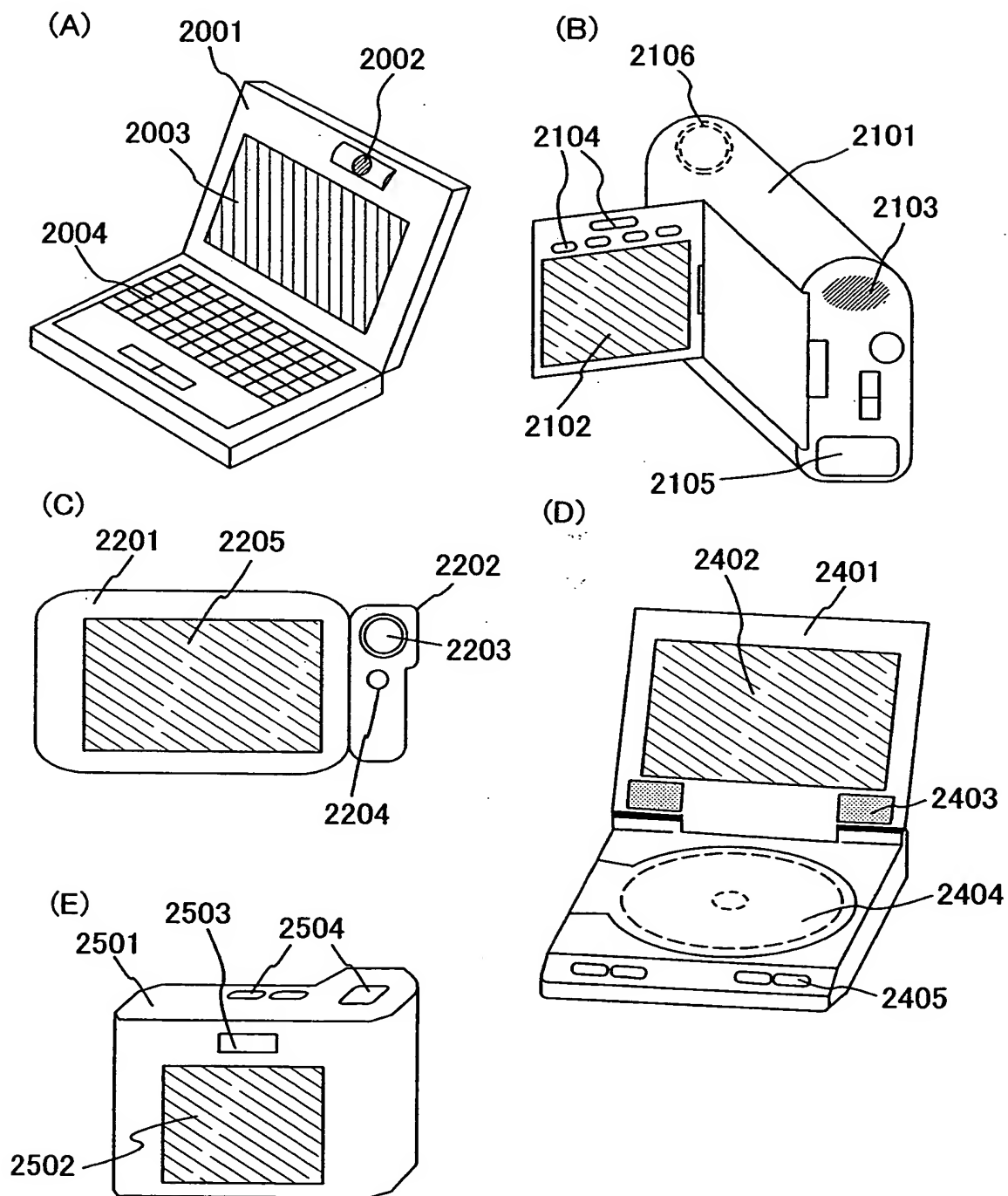
9/12



第10図

10/12

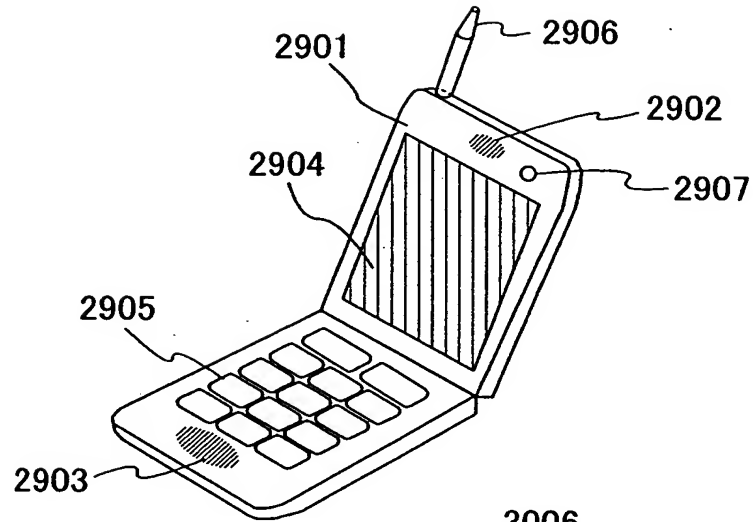




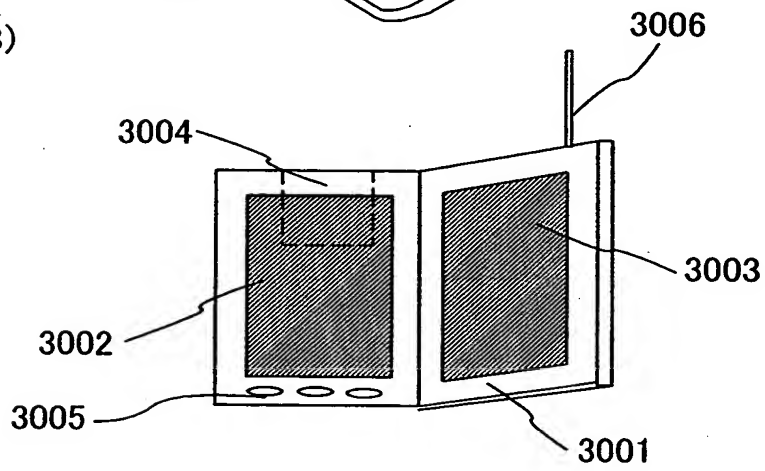
第12図

12/12

(A)



(B)



(C)

